

中信证券股份有限公司
关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”或“公司”或“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。

一、持续督导工作概述

1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场检查的工作要求。

2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。

3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展持续督导工作，并于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 15 日对公司进行了现场检查。

4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导职责，具体内容包括：

（1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料；

（2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自我评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件；

（3）查阅公司与关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告；

(4) 查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告；

(5) 对公司高级管理人员进行访谈；

(6) 对公司及其第一大股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行公开信息查询；

(7) 查询公司公告的各项承诺并核查承诺履行情况；

(8) 通过公开网络检索、舆情监控等方式关注与发行人相关的媒体报道情况。

二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

2023 年，公司经营业绩出现大幅下滑。如相关影响公司业绩的因素改善不达预期，公司可能继续面临业绩下滑的风险。保荐人已在本报告之“三、重大风险事项”之“（二）业绩大幅下滑的风险”对相关风险进行提示。

2023 年，公司经营活动现金流量净额为负且出现较大下滑。若未来公司经营活动现金流量净额继续为负可能导致公司出现流动性风险。保荐人已在本报告之“三、重大风险事项”之“（三）1、经营活动现金流量净额为负的风险”对相关风险进行提示。

保荐人提请公司管理层关注业绩下滑、经营活动现金流量净额为负的情况及导致相关情形的因素，积极采取有效措施加以应对，建议根据自身实际情况合理调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司未来业绩波动的情况，公司应当及时履行信息披露义务，及时、充分地揭示相关风险。

保荐人将本着勤勉尽责的态度对公司上述情况进行持续关注和督导，督促公司改善经营业绩，切实回报全体股东。保荐人提请投资者特别关注公司业绩下滑风险。

三、重大风险事项

本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）经营风险

1、产能储备与市场开发错配的风险

近年来，半导体设备市场周期性波动态势给公司带来相应的经营风险。在行业景气度提升过程中，产业往往加大资本性支出，对相关设备的采购需求增多；在行业景气度下降过程中，产业则可能削减资本支出，进而对设备的采购需求有所下降。公司在报告期内提前储备产能但订单不及预期，短期内导致折旧增加，利润承压。

2、公司研发不能紧跟工艺制程演进及半导体设备更新迭代的风险

遵循“一代技术、一代工艺、一代设备”的规律，半导体设备和半导体设备精密零部件必须紧跟下游需求不断研发升级。目前晶圆制造和半导体设备已向7纳米及更先进的工艺制程演进，对公司的研发能力不断提出更高要求。此外，对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级产品，提高晶圆制造效率，公司须及时研发相匹配的精密零部件或对原有产品持续优化。

若公司产品研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

3、高端技术人才短缺，人才储备不足的风险

半导体设备精密零部件制造业涉及精密机械制造、表面处理特种工艺、焊接等多个技术领域的知识，对技术人才素质有较高的要求。虽然公司可通过规模效应吸引高端人才，满足阶段性发展需要，但从长远来看，高端技术人才的匮乏仍是公司做精做强、提升核心竞争力和国际竞争力的制约因素。

4、规模增长带来的管理风险

公司产品具有多品种、小批量、定制化的特点，与之相匹配的离散型制造模式对公司的管理能力要求较高。公司生产经营规模持续增长、组织架构日益庞大，管理、技术和生产人员数量持续增加，且异地募投项目建成投产后存在跨区域生产等均对公司的管理层和内部管理水平提出了更高的要求。如公司管理能力不能及时匹配公司经营规模增长，将影响公司的生产经营和长远发展。

（二）业绩大幅下滑的风险

2023 年公司营业收入 206,575.59 万元，同比上涨 33.75%，归母净利润 16,868.79 万元，同比下降 31.28%，扣非后归母净利润 8,639.02 万元，同比下降 51.48%，主要系（1）公司产品结构发生变化，毛利相对较低的模组产品收入占比增加，占用机器设备较多的结构零部件类产品收入增长不及预期，公司提前投入的机器设备达产节奏与行业景气度错配，规模效应暂未体现；（2）公司提前储备产能、人才、设备等资源，导致相应人工成本及折旧等费用增加，并对员工进行股权激励，导致管理成本增加；（3）为满足国内半导体设备企业向先进制程升级迭代所需要的新技术需求及产品需求，公司加大研发投入，使得报告期内研发费用增加。

若未来公司经营的规模效应无法得到充分体现、不能及时提供满足市场需求的产品和服务，或下游市场需求发生不利变化，公司将面临业绩继续下滑的风险。

（三）财务风险

1、经营活动现金流量净额为负的风险

公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额为-38,638.18 万元，主要原因系（1）模组类产品收入大幅增长，公司提前采购部分关键物料；（2）公司来自于大陆地区的收入大幅增长，大陆地区客户回款周期相对较慢，且回款方式部分为票据，使得经营性现金流入不及预期；（3）公司提前储备人才，使得支付给职工以及为职工支付的现金增加。

随着公司经营规模和研发规模的不断扩大，公司营运资金需求日益增加，若未来公司经营活动现金流量净额继续为负可能导致公司出现流动性风险。

2、税收优惠及财政补助政策变动的风险

报告期内，扣除对公司利润总额无影响的增值税出口退税，公司其他税收优惠合计金额为 3,600.28 万元，占当年利润总额的比例为 18.33%。公司系高新技术企业，可享受减按 15% 税率缴纳企业所得税的优惠政策的期限至 2025 年 11 月，若未能持续获得高新技术企业认定，公司将不能继续享受前述税收优惠。前述税收优惠变动将对公司盈利能力产生不利影响。

报告期内，公司确认为当期损益的政府补助为 12,284.17 万元，占当年利润总额比例为 62.54%。若未来政策环境发生变化，公司可能无法持续获得政府补助。

3、毛利率波动风险

报告期内，公司产品毛利率为 25.20%，受半导体行业技术迭代、行业景气度、产能预投节奏、地缘政治和原材料价格波动等多种因素影响，存在波动风险，具体包括但不限于：

(1) 半导体设备行业与宏观经济和半导体行业密切相关，且周期波动性更强，宏观经济和行业景气度和公司订单、收入和产能利用率呈正比；

(2) 公司为资本及技术密集型企业，考虑到建设周期，通常需预投产能以满足未来市场需求。若公司产能达产节奏与行业景气度错配，产能利用率和毛利率波动将进一步放大；

(3) 若公司主要出口国家或地区与中国贸易关系恶化，主要出口国家或地区客户可能削减公司订单或寻找非中国大陆的替代供应商。

4、应收账款风险

报告期内，公司应收账款账面价值为 77,752.80 万元，占总资产的比例为 10.24%，公司应收账款周转率为 3.16。

报告期内，随着业务扩张，公司应收账款余额快速提高。随着零部件国产化的不断推进，国内半导体厂商崛起，回款周期较长的大陆地区客户收入和占比持续提升，如未来公司应收账款增长速度过快、主要客户付款周期延长，经营状况出现不利变化，公司应收账款周转率可能下降，继而可能对公司业绩造成不利影响。

5、存货增加导致的风险

报告期内，公司存货账面价值为 90,598.14 万元，占总资产的比例 11.94%，与 2022 年相比同比增长 69.92%。

报告期内，公司产品结构发生变化，原材料占营业成本比例较高的模组产品营业收入同比增长 126.13%，基于该类产品收入的增长以及在手订单的增加，公司提前采购了部分关键原材料。如未来公司不能保持对存货的有效管理，较大的存货规模将对公司业绩造成不利影响。

6、汇率风险

报告期内，公司汇兑损益为 104.09 万元。人民币与美元及其他货币的汇率存在波动，公司的销售、采购等环节均存在以外币计价的情形，公司难以预测市场、外汇政策等因素对汇率的影响程度。因此汇率的波动会影响公司的利润以及现金流。

（四）行业风险

如果未来宏观经济发生剧烈波动，导致 5G 通信、计算机、消费电子、网络通信、汽车电子、物联网等终端市场需求下降，半导体设备厂商、晶圆厂将面临产能过剩的局面，继而大幅削减资本性支出，最终大幅影响公司收入。由于公司为资本及技术密集型企业，资本及持续研发投入较大，若订单和产能利用率大幅下滑，公司业绩亦可能大幅下滑。

全球半导体设备市场由国际厂商主导，与之配套的半导体设备精密零部件制造商主要为美国、日本和中国台湾地区的上市公司。与国际同业相比，公司业务规模较小，资金实力较弱。基于半导体设备精密零部件行业资本及技术密集的特点，若公司不能增强技术储备、提高经营规模、增强资本实力，在行业全球化竞争中，可能导致公司市场竞争力下降、经营业绩下滑。

（五）宏观环境风险

随着国际政治经济环境变化，国际贸易摩擦不断升级，半导体行业成为受到影响较为明显的领域之一，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。

若下游应用领域发展受到宏观经济形势波动的影响，将对公司业务影响较大。若该海外国家或地区继续设置提高关税、进口限制条件或其他贸易壁垒，将对公司外销业务产生不利影响。如果国际政治环境的变化对公司国内客户的生产或销售能力造成不利影响，也会对公司的内销业务造成负面影响。

四、重大违规事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现公司存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

1、主要会计数据

单位：万元

主要会计数据	2023 年	2022 年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	206,575.59	154,446.33	154,446.33	33.75
归属于上市公司股东的净利润	16,868.79	24,545.58	24,563.89	-31.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,639.02	17,805.17	17,823.48	-51.48
经营活动产生的现金流量净额	-38,638.18	-2,232.42	-2,232.42	不适用
	2023 年末	2022 年末		本期末比上年同期末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	456,485.55	464,448.33	464,491.39	-1.71
总资产	758,986.39	664,047.73	664,047.73	14.3

2、主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年		本期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益（元/股）	0.81	1.45	1.45	-44.14
稀释每股收益（元/股）	0.81	1.45	1.45	-44.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.41	1.05	1.05	-60.95
加权平均净资产收益率（%）	3.61	12.19	12.19	减少 8.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.85	8.85	8.85	减少 7.00 个百分点

研发投入占营业收入的比例 (%)	9.97	7.89	7.89	增加 2.08 个百分点
------------------	------	------	------	--------------

(1) 受益于国内半导体市场需求增长，以及零部件国产化需求拉动，公司 2023 年营业收入同比增长 33.75%，公司 2023 年主营业务收入中来自中国大陆地区收入为 143,570.08 万元，同比增长 72.04%，来自中国大陆以外地区收入为 60,177.18 万元，同比下降 13.25%。产品结构方面，工艺零部件产品收入 45,655.21 万元，同比增长 11.95%；结构零部件产品收入 49,094.78 万元，同比下降 1.75%；模组产品收入 92,480.27 万元，同比增长 126.13%；气体管路类产品收入为 16,517.00 万元，同比下降 22.00%。

(2) 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,868.79 万元，同比下降 31.28%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,639.02 万元，同比下降 51.48%，主要原因为：

1) 公司产品结构发生变化，毛利相对较低的模组产品收入占比增加，占用机器设备较多的结构零部件类产品收入增长不及预期，公司提前投入的机器设备达产节奏与行业景气度错配，规模效应暂未体现；

2) 公司提前储备产能、人才、设备等资源，导致相应人工成本及折旧等费用增加，并对员工进行股权激励，导致管理成本增加；

3) 为满足国内半导体设备企业向先进制程升级迭代所需要的新技术需求及产品需求，公司加大研发投入，使得报告期内研发费用增加。

(3) 公司 2023 年经营活动产生的现金流量净额为-38,638.18 万元，主要原因系：

1) 模组类产品收入大幅增长，公司提前采购部分关键物料；

2) 公司来自于大陆地区的收入大幅增长，大陆地区客户回款周期相对较慢，且回款方式部分为票据，使得经营性现金流入不及预期。

3) 公司提前储备人才，使得支付给职工以及为职工支付的现金增加。

(4) 公司 2023 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，分别下降 44.14%、44.14%、60.95%，主要原因系归属于上市公司

股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、与国内外主要半导体设备厂商建立了长期稳定的合作关系

目前，公司已进入的客户供应链体系既包括国际知名半导体龙头设备商，又包括国内主流半导体设备厂商。由于半导体设备厂商对所选用的精密零部件要求极为苛刻，一旦确定合作关系往往长期深度绑定；同时，一旦通过全球主流设备厂家认证，行业内其他厂家会相继跟进与其开展合作，因此公司的客户基础为公司持续经营能力和整体抗风险能力提供了有力保障。

同时，公司基于自身战略布局并为响应客户需求，在海外扩建产能，设立全资子公司，积极推动与海外客户共建稳定合作关系。公司设立境外全资子公司是基于公司战略发展规划的考虑，符合国家政策，有利于进一步扩大公司国际业务规模，拓宽公司产品线，保持技术领先性，增强公司盈利水平，深化公司与国际客户之间的黏性，提高全球供应链采购能力，有效提升国际市场占有率及公司整体抗风险能力。投资项目的实施将有利于带动公司整体发展，增加公司的业务辐射范围，与公司现有产品产生协同效应，提高公司市场竞争优势，有助于公司的长远发展。

2、多种制造工艺、丰富的产品清单和优异的产品性能

半导体设备精密零部件行业所需的资本和研发投入门槛较高，各家均有独特的生产 Know-How，行业内大多数企业只专注于个别工艺技术，或特定零部件产品，而公司已形成了达到全球半导体设备龙头企业标准的多种制造工艺和产能。

公司多种的制造工艺、丰富的产品清单和优异的产品性能有利于客户降低供应链成本、提升采购效率，使得双方合作关系更加紧密。

3、离散型制造企业柔性化、智能化管理优势

公司在精密零部件制造行业进行了长期的生产管理实践，对“多品种、小批量、定制化”的离散型制造企业的管理特点具有较为深刻的认识和理解，致力于实现柔性化和智能化生产管理。公司开发共性半导体精密零部件技术平台系统，

可将复杂的首件分解成大量公司已积累的标准化模板，降低对人工经验的依赖，实现工艺整合、利用一台设备完成多道加工工序以及一体化在线生产与检测，保证了产品质量的稳定与生产效率的提高。

通过标准化操作、柔性化管理，规范业务处理流程，保证每项业务和制造流程的各个环节均处可控状态，产品品质和可靠性得到了客户的认可。

（二）核心竞争力变化情况

本持续督导期间，保荐人通过查阅同行业上市公司及市场信息，查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈等，未发现公司的核心竞争力发生重大不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	20,601.63	12,184.83	69.08%
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	20,601.63	12,184.83	69.08%
研发投入总额占营业收入比例 (%)	9.97%	7.89%	增 2.08 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)	-	-	-

2023 年，公司研发费用同比增长 69.08%，主要系报告期内公司加大新产品、新技术的投入，导致人工以及材料方面投入增加所致。

（二）研发进展

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能涂层工艺开发项目	33,450.00	13,447.82	21,002.07	持续研发	1、开发出热喷涂及原子层沉积技术，并应用于腔体、内衬、匀气盘等核心零部件； 2、完成产品清洗标准制定； 3、开发出高反射镀金工艺，制作镀金标准工艺制程规范；	国内领先	可应用于刻蚀、CVD、ALD、PECVD 等关键制程设备中核心零件

2	核心功能部件开发项目	23,337.00	5,155.66	9,384.12	持续研发	1、攻克精孔高粗糙度要求、台阶异形孔精密加工技术、不锈钢金属高耐腐蚀性技术要求；标准化操作、刀具管控等工艺标准开发；设计开发自动化产线； 2、建立设计及制造高精度气路阀组件的能力，建立测试能力及平台； 3、实现集成电路化学机械抛光设备中保持环零部件产品的国产化开发；	国内领先	可应用于刻蚀、薄膜沉积、化学机械抛光等设备。
合计	/	56,787.00	18,603.48	30,386.19	/	/	/	/

注：在研项目取自截至报告期末公司研发预算排名前十项目，并通过研发项目类别进行归纳整理后列示。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

本持续督导期间，保荐人通过查阅公司招股说明书、定期报告及其他信息披露文件，对公司高级管理人员进行访谈，基于前述核查程序，保荐人未发现公司存在新增业务。

九、募集资金的使用情况及是否合规

本持续督导期间，保荐人查阅了公司募集资金管理使用制度、募集资金专户银行对账单和募集资金使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募集资金使用情况鉴证报告，对公司高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期间，公司已建立募集资金管理制度并予以执行，募集资金使用已履行了必要的决策程序和信息披露程序，基于前述检查未发现违规使用募集资金的情形。

由于“集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地”项目投资规模及建设计划的调整，同时为提高生产效率，公司对部分产品进行持续的工艺设计优化，需对原规划采买的部分设备或产线进行相应调整，导致验收时间延缓。公司于

2023年11月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将该项目达到预定可使用状态日期，由2023年11月调整至2024年5月。公司对上述事项及时进行了披露。

十、第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至2023年12月31日，公司第一大股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员所持股份均不存在质押、冻结及减持情形。

十一、保荐人认为应当发表意见的其他事项

基于前述保荐人开展的持续督导工作，本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司
2023 年度持续督导跟踪报告》之签署页）

保荐代表人：

张欢

张 欢

张明慧

张明慧

